



Manual paso a paso: de Elephone S8 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,24 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la parte trasera a unos 65°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Sacamos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desencajamos haciendo palanca por todo el contorno.

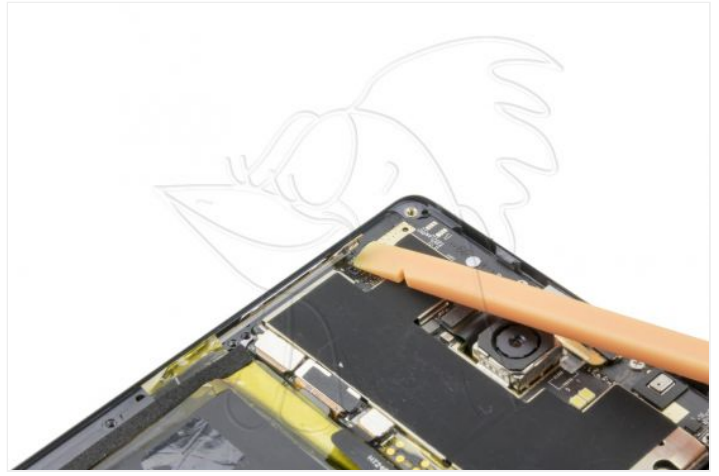




Paso 3 - Desconectar componentes

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la placa y desconectamos los componentes que están conectados a esta.





Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que todavía sujetan la placa base y también sacamos la bandeja SIM/SD. Ahora ya podemos desencajar la placa base del chasis.



Paso 5 - Placa base

Para terminar, solo falta despegar el blindaje con sensor de proximidad y contactos de altavoz.

